技术指标及商务要求响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明(无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| HD主控板采购项目 | 1 | HD主控板 | 主控板尺寸包络：不超过400 mm × 160 mm × 30 mm |  |  |
| 2 | 功耗：≤50W |  |  |
| 3 | 重量：≤1 kg |  |  |
| 4 | 能够实现两路3 GSa/s，12 bit高速采样和数据处理。 |  |  |
| 5 | 具有电源管理功能，接收电源模块的+12V电源，给外围光电设备提供+5V（15A）和+12V（4A）的直流供电。 |  |  |
| 6 | 具有上位机测控模块，完成和上位机的通信功能、外设控制参数/指令设置功能、外设状态参数监测上报功能。 |  |  |
| 7 | 具有CM通信模块，完成和CM模块的通信功能，获取D参数和E参数。 |  |  |
| 8 | 具有HD控制模块，完成反馈强度控制、注入强度控制、业务偏振控制等HDE控制功能，完成HD偏振控制、注入强度控制、业务偏振控制等HDD控制功能。控制环路频率10 Hz ~ 1 kHz，其中HD偏振控制涉及2路3 GSa/s，12 bit的高速采样和数据处理。 |  |  |
| 9 | 上位机软件 | 上位机软件，完成和HD主控板的通信功能、外设控制参数/指令设置功能、外设状态参数监测显示功能。 |  |  |
| 10 | 数据显示和存储功能。 |  |  |
| 11 | 交付条件 | 硬件交付物：HD主控板，数量2，程序烧录仿真器及线缆。软件交付物：HD主控软件（烧录程序、软件源码）、上位机显控软件（程序及源码）。产品资料交付物：HD主控板设计方案（软硬件设计方案）、使用手册、硬件原理图、PCB文件、物料明细表、测试记录、验收细则；上位机软件使用说明。 |  |  |
| 12 | 验收条件 | （1）按照技术协议要求验收（2）按照合同约定要求验收 |  |  |
| 13 | 其他 | 在系统联调阶段需派遣专人在委托方制定地点（成都市范围内）配合进行系统联调工作。并根据联调阶段发现问题所形成的意见完成改版。 |  |  |

 公司名称（盖章）：

 日期：